

Vielseitigkeit und Multifunktionalität erwarten die Besucher auf dem AP&S Stand 621 in Halle A4 auf der Semicon Europa 2018

Vom 13. zum 16. November 2018 findet im Rahmen der Electronica die Semicon Europa, Leitmesse des europäischen Halbleitermarktes, in München statt. Auch dieses Jahr ist AP&S als Aussteller mit von der Partie. Neben einer Vielzahl von technologischen Highlights, soll das Unternehmen als Ganzes in Fokus stehen.

„Wir möchten unseren Besuchern ein Messeerlebnis bieten, bei welchem Sie AP&S besser kennenlernen. Unsere Produkte und Dienstleistungen sind vielseitig, die aktuellen Unternehmensentwicklungen ebenso. Aktuell investieren wir 3,5 Millionen Euro in den Bau eines neuen Reinraums und einer zusätzlichen Fertigungshalle am Hauptsitz in Donaueschingen. Diese Investition bringt wesentliche Vorteile für unsere Kunden, welche natürlich ein Thema sein werden. Auch bietet die Präsenz in München uns die Gelegenheit, unsere diesjährige Auszeichnung als Top 100 Innovator gemeinsam mit unseren Kunden zu feiern“ erklärt Tobias Bausch, Director Sales & Marketing AP&S.

Zum ersten Mal wird die neue AP&S Nassprozessanlage TeraStep® vorgestellt. DAS MULTI-TOOL überzeugt durch seine Multifunktionalität, denn die Anlage verarbeitet sowohl 12“ als auch 8“ Wafer, double stacked bis extra dünne Wafer, Chemie und Lösungsmittel sowie verschiedene Kontaminationsstypen.

Bei der Einzelwafer-Ätzverarbeitung setzt das Unternehmen auf die Schlüsselfunktion Endpoint detection. Die SpinStep® Prozessanlagen, mit diesem System ausgerüstet, bieten verbesserte Prozessstabilität, hohe Reproduzierbarkeit und ermöglichen die Rückführung der Prozessmedien.

Predictive maintenance and fab-planning 4.0 werden durch die AP&S Augmented Reality Lösung ermöglicht. Mit dem Kundennutzen im Fokus bietet es: optimierte Fertigungsplanung; lösungsorientierten Konstruktionsprozess; Zeit- und Kosteneinsparungen und planmäßigen Austausch von Ersatzteilen. Vorgestellt wird diese Innovation auch im Fab Management Forum am Dienstag, den 13. November um 15:10.

Ein weiterer AP&S Vortrag findet in der TechLounge zum Thema „UBM Metallization Technology for advanced semiconductor devices“ am Donnerstag, den 15. November um 11:45 statt. Hierbei werden den Zuhörern die grundlegenden Aspekte, Vorteile sowie entscheidenden Parameter eines erfolgreichen e-less Prozesses vorgestellt.

Über AP&S International GmbH:

Die AP&S International GmbH ist ein weltweit agierender Spezialist für die Entwicklung und den Bau von Nassprozessanlagen, die beispielsweise bei der Fertigung mikroelektronischer Chips eingesetzt werden. Zum internationalen Kundenkreis des Unternehmens zählen namhafte Firmen aus der Halbleiterindustrie, der Opto-Elektronik und der Sensorik. Deutschlandweit sind 125 Mitarbeiter für das Unternehmen tätig, hinzu kommen weitere Niederlassungen in Malaysia, Singapur, China und Italien. Mehr Infos unter www.ap-s.de

AP&S International GmbH

Aljona Barberio
PR Kontakt

Obere Wiesen 9 | Aasen
78166 Donaueschingen | Germany
Tel: +49 771 8983 154
E-Mail: aljona.barberio@ap-s.de
Internet: www.ap-s.de